

## 杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C81 版)  
三、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺(一)公司承诺  
若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利息及计算的利息或相关监管部门认可的其他价格确定(如公司股票因发现现金红利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，新股数量亦相应进行除权调整)，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

若因本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(二)控股股东、实际控制人承诺

若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将极力促使发行人回购首次公开发行的全部新股，并依法回购已转让的原限售股份。

若发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(三)全体董事、监事、高级管理人员承诺

若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(四)本次发行相关中介机构的承诺

(一)保荐机构东方证券承销保荐有限公司承诺  
拟发行人在首次公开发行股票时，若因东投行为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

(二)发行人律师国浩律师(上海)事务所承诺

因国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协调、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，公开并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的可识别的经济损失，选择与投资者和解，通过第三方与投资者达成和解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

(三)发行会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺

因中汇为发行人首次公开发行股票并在上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明中汇没有过错的除外。

(四)公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

发行人本次公开发行前持股 5%以上股东王玉生、宁波利时、泓祥投资承诺：在股份锁定期满后，本人/本公司每年减持发行人股份的总数不超过本人/本公司本企业持有的发行人股份总数。其中，本人/本公司每年通过集中竞价交易方式减持发行人股份的比例不超过 40%；(3)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

十、老股转让的新股方案

本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份(老股转让)。

(十一)本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险

(一)技术风险

半导体硅片属于半导体的支撑材料行业，其核心工艺包括单晶工艺、成形工艺、抛光工艺、外延工艺等，技术专业化程度颇高，从全球范围来看，半导体硅片(4 英寸)最早量产于世纪 80 年代，行业经过多年的竞争与洗牌，目前日本、德国、台湾等国家或地区的少数几家厂商垄断了全球九成以上的市场份额，且主流产品尺寸已经达到 12 英寸，而我国半导体硅片行业起步较晚，目前国内能够实现半导体硅片量产的本土企业也仅有十余家，且绝大部分企业能够量产 8 英寸以下的半导体硅片相似，全球半导体硅片行业具有较高的壁垒。

(二)行业政策风险

公司主营业务产业链长，产品种类繁多，存货较大等因素影响，公司流动比率、速动比率较低，报告期内，公司的流动比率分别为 1.68、1.53、1.07 和 1.06，公司的流动比率分别为 0.15、0.15、0.72 和 0.68，报告期末公司存在一定的偿债风险。未来，为了保持公司的竞争优势，公司仍将在 8 英寸硅片及 12 英寸硅片及第一代半导体封测集成电路芯片方面加大资金投入，如果公司不能及时补充现金流，将可能对公司的经营产生不利影响。

(三)汇率风险

目前在半导体硅片方面，公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位，在分立器件方面，公司的传统优势产品肖特基二极管芯片在业内也具有较强的市场竞争力，同时，在砷化镓微波射频集成电路芯片产品的开发研制方面，公司通过持续的研发投入，也已取得了核心技术方面的突破，但未来公司要在半导体硅片、半导体分立器件、集成电路芯片方面的技术研发与革新速度不能满足客户的需求，从而影响公司的发展。

(四)市场竞争风险

目前在半导体硅片方面，公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位，在分立器件方面，公司的传统优势产品肖特基二极管芯片在业内也具有较强的市场竞争力，同时，在砷化镓微波射频集成电路芯片产品的开发研制方面，公司通过持续的研发投入，也已取得了核心技术方面的突破，但未来公司要在半导体硅片、半导体分立器件、集成电路芯片方面的技术研发与革新速度不能满足客户的需求，从而影响公司的发展。

(五)募集资金投资项目的风险

1. 如本人未能履行，确认无法履行或无法按期履行的，因相关法律诉讼，政策变化、自然灾害及其他不可抗力因素导致本人未能履行或无法履行的，本人将承担以下责任：(1)本人未能履行或无法履行的，本人将赔偿公司因本人未能履行或无法履行或无法按期履行的具体原因(2)倘若本人及未授权代理人擅自使用或代理他人使用本人名义向公司提出索赔，(3)将不支付补偿金额代偿代表公司利益的自然人或法人，(4)本人违反承诺的，本人将赔偿公司因此产生的所有损失。

2. 如因相关法律诉讼，政策变化、自然灾害及其他不可抗力因素导致本人未能履行或无法履行或无法按期履行的，本人将承担以下责任：(1)通过立昂东芯充分披露本人未能履行或无法履行或无法按期履行的具体原因(2)向本人及未授权代理人提出公开承诺或代替承诺，以尽可能履行或无法按期履行的具体原因。

3. 如本人未能履行，确认无法履行或无法按期履行的，本人将承担以下责任：(1)通过立昂东芯充分披露本人未能履行或无法履行或无法按期履行的具体原因(2)向本人及未授权代理人提出公开承诺或代替承诺，以尽可能履行或无法按期履行的具体原因。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)发行人及相关股东、实际控制人、董事、高管关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：

1. 加强募集资金管理

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。

2. 完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，《公司章程》明确了有关利润分配政策的决策程序和程序的相关条款，为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了公司上市后未来三年分红回报规划。公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

3. 积极实施募投项目

本次募集资金全部用于公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、筹资资金先期投入建设，以争取早日产生收益。

4. 积极提升公司竞争力和盈利能力

公司致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

5. 关于后续事项的承诺

公司承诺根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

(二)发行人控股股东、实际控制人、董事、高管关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司控股股东、实际控制人王敏文对公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行作出如下承诺：

“本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出如下承诺：

(一)公司承诺  
若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利息及计算的利息或相关监管部门认可的其他价格确定(如公司股票因发现现金红利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，新股数量亦相应进行除权调整)，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

若因本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(二)控股股东、实际控制人承诺

若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将极力促使发行人回购首次公开发行的全部新股，并依法回购已转让的原限售股份。

若发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(三)全体董事、监事、高级管理人员承诺

若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

(四)本次发行相关中介机构的承诺

(一)保荐机构东方证券承销保荐有限公司承诺  
拟发行人在首次公开发行股票时，若因东投行为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

(二)发行人律师国浩律师(上海)事务所承诺

因国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协调、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，公开并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的可识别的经济损失，选择与投资者和解，通过第三方与投资者达成和解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

(三)发行会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺

因中汇为发行人首次公开发行股票并在上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明中汇没有过错的除外。

(四)公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

发行人本次公开发行前持股 5%以上股东王玉生、宁波利时、泓祥投资承诺：在股份锁定期满后，本人/本公司每年减持发行人股份的总数不超过本人/本公司本企业持有的发行人股份总数。其中，本人/本公司每年通过集中竞价交易方式减持发行人股份的比例不超过 40%；(3)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

十、老股转让的新股方案

本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份(老股转让)。

(十一)本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险

(一)技术风险

半导体硅片属于半导体的支撑材料行业，其核心工艺包括单晶工艺、成形工艺、抛光工艺、外延工艺等，技术专业化程度颇高，从全球范围来看，半导体硅片(4 英寸)最早量产于世纪 80 年代，行业经过多年的竞争与洗牌，目前日本、德国、台湾等国家或地区的少数几家厂商垄断了全球九成以上的市场份额，且主流产品尺寸已经达到 12 英寸，而我国半导体硅片行业起步较晚，目前国内能够实现半导体硅片量产的本土企业也仅有十余家，且绝大部分企业能够量产 8 英寸以下的半导体硅片相似，全球半导体硅片行业具有较高的壁垒。

(二)行业政策风险

公司主营业务产业链长，产品种类繁多，存货较大等因素影响，公司流动比率、速动比率较低，报告期内，公司的流动比率分别为 1.68、1.53、1.07 和 1.06，公司的流动比率分别为 0.15、0.15、0.72 和 0.68，报告期末公司存在一定的偿债风险。未来，为了保持公司的竞争优势，公司仍将在 8 英寸硅片及 12 英寸硅片及第一代半导体封测集成电路芯片方面加大资金投入，如果公司不能及时补充现金流，将可能对公司的经营产生不利影响。

(三)汇率风险

目前在半导体硅片方面，公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位，在分立器件方面，公司的传统优势产品肖特基二极管芯片在业内也具有较强的市场竞争力，同时，在砷化镓微波射频集成电路芯片产品的开发研制方面，公司通过持续的研发投入，也已取得了核心技术方面的突破，但未来公司要在半导体硅片、半导体分立器件、集成电路芯片方面的技术研发与革新速度不能满足客户的需求，从而影响公司的发展。

(四)市场竞争风险

目前在半导体硅片方面，公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位，在分立器件方面，公司的传统优势产品肖特基二极管芯片在业内也具有较强的市场竞争力，同时，在砷化镓微波射频集成电路芯片产品的开发研制方面，公司通过持续的研发投入，也已取得了核心技术方面的突破，但未来公司要在半导体硅片、半导体分立器件、集成电路芯片方面的技术研发与革新速度不能满足客户的需求，从而影响公司的发展。

(五)募集资金投资项目的风险

1. 如本人未能履行，确认无法履行或无法按期履行的，因相关法律诉讼，政策变化、自然灾害及其他不可抗力因素导致本人未能履行或无法履行的，本人将承担以下责任：(1)本人未能履行或无法履行的，本人将赔偿公司因本人未能履行或无法履行或无法按期履行的具体原因(2)倘若本人及未授权代理人擅自使用或代理他人使用本人名义向公司提出索赔，(3)将不支付补偿金额代偿代表公司利益的自然人或法人，(4)本人违反承诺的，本人将赔偿公司因此产生的所有损失。

2. 如因相关法律诉讼，政策变化、自然灾害及其他不可抗力因素导致本人未能履行或无法履行或无法按期履行的，本人将承担以下责任：(1)通过立昂东芯充分披露本人未能履行或无法履行或无法按期履行的具体原因(2)向本人及未授权代理人提出公开承诺或代替承诺，以尽可能履行或无法按期履行的具体原因。

3. 如本人未能履行，确认无法履行或无法按期履行的，本人将承担以下责任：(1)通过立昂东芯充分披露本人未能履行或无法履行或无法按期履行的具体原因(2)向本人及未授权代理人提出公开承诺或代替承诺，以尽可能履行或无法按期履行的具体原因。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)发行人及相关股东、实际控制人、董事、高管关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：

1. 加强募集资金管理

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。

2. 完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，《公司章程》明确了有关利润分配政策的决策程序和程序的相关条款，为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了公司上市后未来三年分红回报规划。公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

3. 积极实施募投项目

本次募集资金全部用于公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、筹资资金先期投入建设，以争取早日产生收益。

4. 积极提升公司竞争力和盈利能力

公司致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

5. 关于后续事项的承诺

公司承诺根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

(二)发行人控股股东、实际控制人、董事、高管关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司控股股东、实际控制人王敏文对公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行作出如下承诺：

“本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

果公司未来不能正确把握行业发展动态和市场需求变化，持续推动技术研发、生产工艺创新以及产品升级，建立并保持核心产品的市场竞争力，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位，进而影响公司的经营业绩。

(四)固定资产管理、产能爬坡期较长的风险

半导体硅片及分立器件芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业。尤其是半导体硅片，企业要形成规模化、商业化的生产，需要进行巨额巨大的固定资产投资，譬如一批光机设备的价格可能高达数千万元，而 12 英寸以上大尺寸硅片生产线的投资规模更是数十亿人民币。同时，大规模的资金投入后，半导体硅片、分立器件芯片的生产需从设备工艺调试、到产品下游验证，再到大规模量产，需要大量的技术人员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点，半导体硅片及分立器件芯片的生产从投产至达产需要较长时间，产能爬坡期较长。因此，在生产能力到达设计产能之前，通常需要经历一个相对较长的产能爬坡期。因此，在生产能力到达设计产能之前，通常需要经历一个相对较长的产能爬坡期。

如果公司不能顺利地完成产能爬坡，前期的长期投资折旧与摊销等固定成本将在一定程度上影响公司的盈利能力。

(五)原材料价格波动风险

公司生产所用主要原料为多晶硅、石英坩埚、石墨件、包装盒、切磨材料、抛光材料、外延材料、靶材、金属溅射粉等，其价格变化对公司利润具有一定影响。报告期各期，原材料成本占主营业务成本的比例分别为 51.80%、48.26%、48.71% 和 52.2%，主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本，扩大产能实现规模经济，但是与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材料价格波动给生产经营带来不利影响的风险。

(六)应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 31,670.29 万元、35,589.17 万元、41,259.91 万元和 45,259.54 万元，占流动资产的比例分别为 26.55%、20.10%、22.97% 和 24.95%。报告期末，公司 99.00%以上的应收账款账龄均在一年以内，应收账款对象主要为华润华联、扬州虹桥、中芯国际等知名半导体厂商，上述客户良好，实力雄厚，与公司有着良好的合作关系，但如果客户经营状况发生重大不利变化